

上海天承科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场调研 ☐电话会议 ☐其他
参会单位	通过上证路演中心参与“科创板 2026 年半年度新材料行业集体业绩说明会”的投资者
调研时间	2026 年 9 月 18 日（周五）15:00-17:00
会议地点	上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：童茂军 董事会秘书、副总经理：郝锴 首席技术官：韩佐晏 财务负责人：王晓花 独立董事：石建宾
投资者关系活动主要内容记录	网络文字互动问答 （一）中报显示公司目前同时推进多个在建产能项目，请问当前的建设进展分别如何？公司在拓展新领域产品主要面临哪些？请问公司半导体化学品业务的进展如何？ 答复： 尊敬的投资者您好，公司目前同时推进的各项产能项目正在有序推进中，具体进度请关注公司相关进展公告和定期报告。公司在拓展新领域产品时面临的主要问题是新产品应用开发以及客户关系等。公司半导体领域产品目前布局了大马士革、TSV、TGV、RDL、bumping 等各类工艺的电镀液添加剂产品（包括铜镍、锡银），应用于前道晶圆制造、先进封装等领域，团队积极与存储&逻辑 fab、封装、面板、光

	电等各类头部客户互动，正在加速发展中。感谢您的关注！ （二）当前地缘冲突叠加全球能源供给失衡，针对原材料价格波动风险，公司有哪些应对举措？ 答复： 尊敬的投资者您好，针对原材料价格和供应波动，公司搭建了多维度的风控体系，通过多供应商备选、工艺降本增效、动态库存管理等多种方式降低原料波动带来的影响。目前公司供应链运转顺畅，原材料供应和成本可控范围内，公司也会持续跟踪全球市场变化，动态调整应对策略，保障公司经营稳定。感谢您的关注！ （三）行业复苏预期下，公司配套 PCB、半导体材料的新建产能规划是怎样的？ 答复： 尊敬的投资者您好，在当前 AI 算力、人工智能等飞速发展的驱动下，高端 PCB 发展迅速、规模提升。公司积极推进产能建设以应对下游需求量的扩张，其中泰国预计建设 3 万吨产能的生产基地，珠海工厂与泰国工厂完成投产后，产能预计较当前翻 3 倍，公司目前半导体集成电路工厂年产能可满足当前增长需求。公司紧抓国产替代以及客户产品的升级机遇，积极推动产品的推广和销售，将尽快完成后续新工厂产能利用率的提升，感谢您的关注！
附件清单	无
日期	2026 年 9 月 21 日